

事務局説明資料

2025年10月17日(金)

＜ 共同事務局 ＞

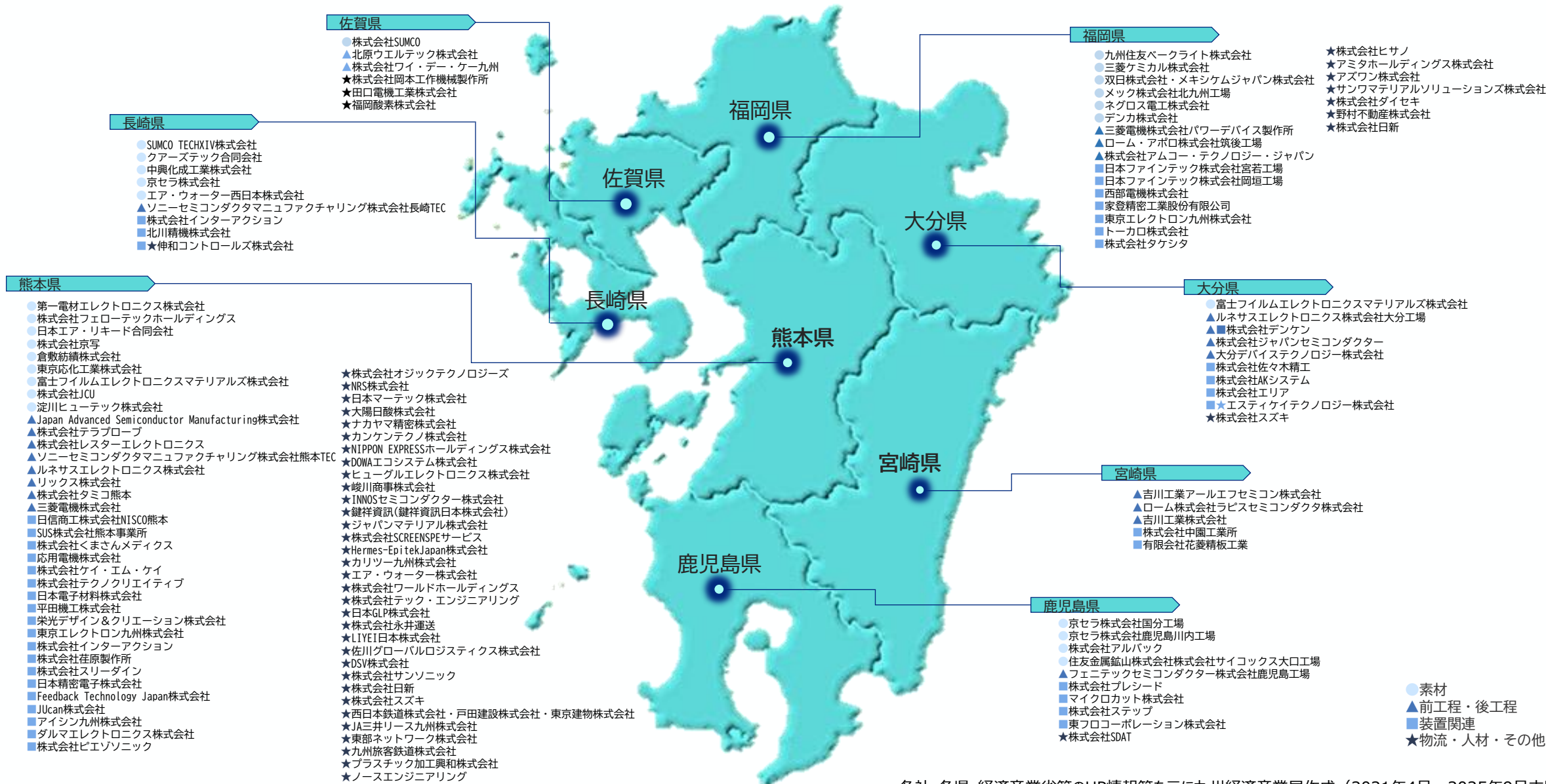
経済産業省 九州経済産業局

(一社)九州半導体・デジタルイノベーション協議会

九州の半導体産業の動向（福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島）

企業の主な設備投資計画・立地協定

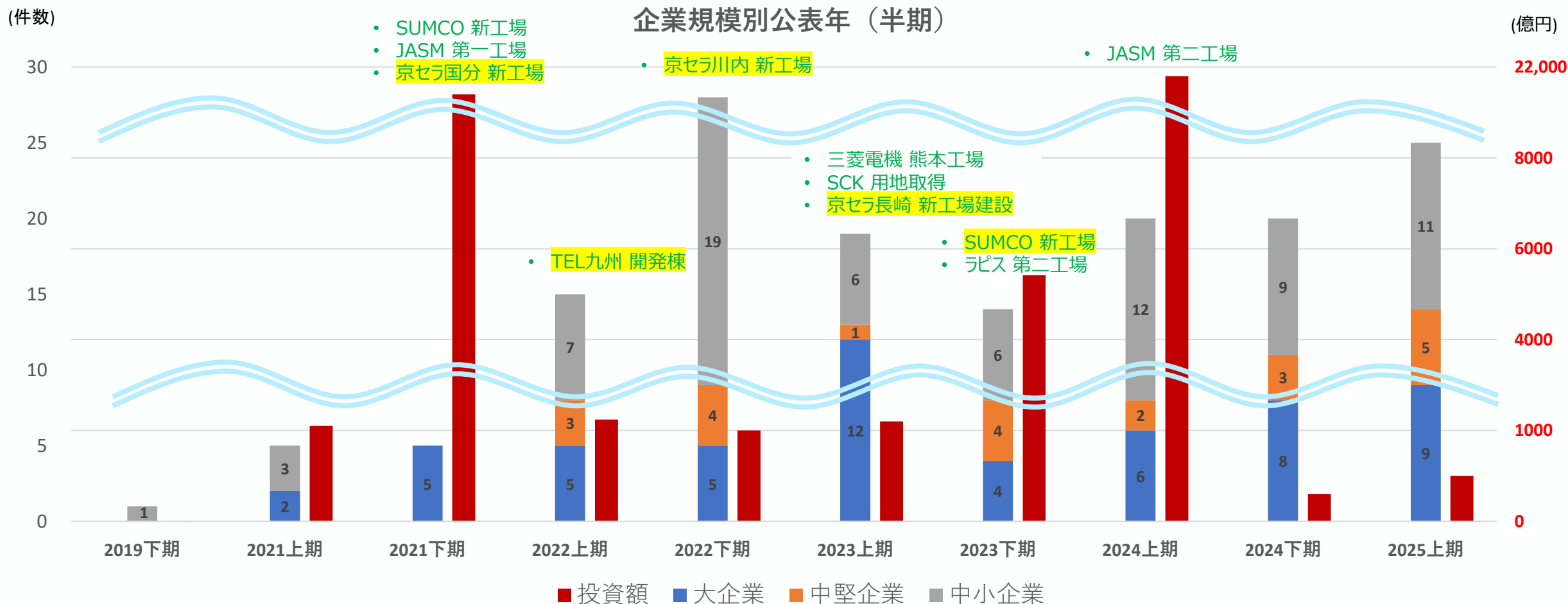
7県合計162件、4兆8,158億円超(金額は公表企業分等の合計額)



九州への新規立地・設備投資の動向

黄色ハイライトは従来資料に加えて100億円以上の投資案件を追加ピックアップ

- 九州への新規立地・設備投資表明は、JASMの進出表明から3年以上経過した現在でもペースを持続。特に2025年1～6月は前年を上回るペースで投資が表明されている。
- 2021年下期のJASM進出に続き、2022年以降は中堅・中小企業による投資が続く。



九州半導体人材育成等コンソーシアム

- 「半導体人材の育成・確保」「サプライチェーン強靱化」等を目的に、2022年3月設立（45→155機関※）
- 全体会合では、活動の方向性を決定。各機関による取組を共有し、連携を促す。
- 個別具体的な活動の企画立案・実行は、ワーキンググループ（WG）が担う。

※2025年10月15日時点

【活動の方向性】

- 1) 半導体人材の育成・確保（WG）
- 2) 半導体大手と地場・ユーザー企業との取引強化（WG）
- 3) 海外との産業交流促進

【共同事務局】

- ・九州経済産業局
- ・（一社）九州半導体・デジタルイノベーション協議会（SIIQ）

※全体推進（全体会合：155機関）

九州半導体人材育成等コンソーシアム

（代表幹事：九州経済産業局長、SIIQ※筆頭副会長）

※（一社）九州半導体・デジタルイノベーション協議会
会員数：370（2025年8月末時点）

※具体的活動の推進（2つのWG）

人材育成WG

サプライチェーン
強靱化WG

※「海外との産業交流促進」

全国に
横展開

連携

地域版コンソーシアム

福岡県

（令和4年2月）

佐賀県

（令和4年10月）

長崎県

（令和4年2月）

熊本県

（令和4年3月）

大分県

（平成17年4月）

宮崎県

（令和5年12月）

鹿児島県

（令和7年8月）

北九州市

（令和4年7月）

※（ ）内は組成時期
九州経済産業局も参画

新規構成機関（ご紹介）

- 九州半導体人材育成等コンソーシアムは、155機関の産・学・官・金で構成。 ※2025年10月15日時点
- 新規に参画した構成機関は以下の6機関（産業界：5、協力機関：1）。

参画日	産学官金	構成機関名	所在地	業種等	参加WG
4月3日	産業界	株式会社SANMATSU	福岡県	薄型板金加工	人材・SC
4月3日	産業界	日本アイ・ビー・エム株式会社 東京基礎研究所	東京都	研究所	人材
5月26日	産業界	株式会社リョーサン	福岡県	エレクトロニクス商社	SC
8月8日	協力機関	一般財団法人 日本気象協会 九州支社	福岡県	財団法人	SC
10月8日	産業界	NTTドコモビジネス株式会社	東京都	情報通信業	人材・SC
10月10日	産業界	豊田通商株式会社	愛知県	商社	SC

○九州半導体人材育成等コンソーシアム構成機関一覧

産業界	1	旭化成エレクトロニクス株式会社
	2	旭化成マイクロテクノロジー株式会社
	3	株式会社アスカインデックス
	4	アドバンスソフト株式会社
	5	株式会社アムコー・テクノロジー・ジャパン
	6	株式会社アルプス物流
	7	株式会社ウイルテック
	8	エア・ウォーター株式会社
	9	株式会社エイジェック
	10	エスアイユー株式会社
	11	SMC株式会社
	12	NRS株式会社
	13	株式会社荏原製作所 熊本事業所
	14	NTTドコモビジネス株式会社
	15	株式会社オジックテクノロジーズ
	16	九州電子株式会社
	17	株式会社九州日新
	18	株式会社近鉄ロジスティクス・システムズ
	19	株式会社くまさんメディクス
	20	計測エンジニアリングシステム株式会社
	21	興研株式会社
	22	櫻井精技株式会社
	23	株式会社SUMCO
	24	株式会社SANMATSU
	25	株式会社ジーダット
	26	Japan Advanced Semiconductor Manufacturing株式会社
	27	株式会社ジャパンセミコンダクター
	28	JSR株式会社
	29	株式会社スズキ
	30	株式会社スタッフサービス
	31	ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング株式会社
	32	株式会社タケシタ
	33	田中藍株式会社
	34	田中電子工業株式会社
	35	中央電子工業株式会社
	36	TXOne Networks Japan合同会社
	37	株式会社テラプローブ
	38	株式会社デンケン

産業界	39	株式会社デンソー
	40	東京エレクトロン九州株式会社
	41	東京応化工業株式会社
	42	東芝情報システム株式会社
	43	東洋ワーク株式会社
	44	豊田通商株式会社
	45	株式会社西村ケミテック
	46	日研トータルソーシング株式会社
	47	日清紡マイクロデバイスAT株式会社
	48	日総工産株式会社
	49	日本アイ・ビー・エム株式会社 東京基礎研究所
	50	日本シノプシス合同会社
	51	株式会社日本マイクロニクス
	52	株式会社ヒサノ
	53	株式会社日出ハイテック
	54	平井精密工業株式会社
	55	株式会社平山GL
	56	株式会社ピーエムティー
	57	フジアルテ株式会社
	58	株式会社藤田ワークス
	59	株式会社BREXA Next
	60	マイクロカット株式会社
	61	株式会社マイスティア
	62	株式会社マイナビ
	63	三井不動産株式会社
	64	三菱電機株式会社 パワーデバイス製作所
	65	三菱マテリアル株式会社
	66	株式会社安川電機
	67	UTエიმ株式会社
	68	横河ソリューションサービス株式会社
	69	吉川工業株式会社
	70	ラピスセミコンダクタ株式会社 宮崎工場
	71	ラムリサーチ合同会社
	72	リクルーティング・パートナーズ株式会社
	73	ルネサスエレクトロニクス株式会社
	74	株式会社リョーサン
	75	ロジスティード九州株式会社
	76	株式会社ワールドインテック

○九州半導体人材育成等コンソーシアム構成機関一覧

教育機関	77	学校法人岩崎学園
	78	国立大学法人大分大学
	79	開新高等学校
	80	国立大学法人鹿児島大学
	81	北九州工業高等専門学校
	82	国立大学法人九州工業大学
	83	九州産業大学
	84	九州職業能力開発大学校
	85	国立大学法人九州大学
	86	学校法人近畿大学 産業理工学部（福岡キャンパス）
	87	熊本県立技術短期大学校
	88	熊本県立熊本工業高等学校
	89	学校法人開新学園 熊本工業専門学校
	90	熊本高等専門学校
	91	国立大学法人熊本大学
	92	久留米工業大学
	93	独立行政法人国立高等専門学校機構
	94	国立大学法人佐賀大学
	95	佐世保工業高等専門学校
	96	崇城大学
	97	第一工科大学
	98	東海大学熊本キャンパス
	99	長崎県立長崎工業高等学校
	100	国立大学法人長崎大学
	101	学校法人西日本工業大学
	102	学校法人福岡大学
	103	学校法人福岡工業大学
	104	熊本県立水俣高等学校
	105	都城工業高等専門学校
	106	国立大学法人宮崎大学
	107	柳商学園 柳川高等学校
	108	福岡県立八女工業高等学校
	109	立命館アジア太平洋大学
	110	学校法人 早稲田大学 情報生産システム研究センター
行政機関	111	福岡県
	112	佐賀県
	113	長崎県
	114	熊本県
	115	大分県

行政機関	116	宮崎県
	117	鹿児島県
	118	北九州市
	119	福岡市
	120	熊本市
	121	財務省長崎税関
	122	文部科学省
	123	国土交通省九州運輸局
	124	国土交通省九州地方整備局
	125	経済産業省（本省）
金融機関	126	株式会社大分銀行
	127	株式会社熊本銀行
	128	株式会社佐賀銀行
	129	株式会社十八親和銀行
	130	株式会社西日本シティ銀行
	131	株式会社日本政策金融公庫
	132	株式会社日本政策投資銀行九州支店
	133	株式会社福岡銀行
	134	株式会社肥後銀行
	135	株式会社三菱UFJ銀行
	136	株式会社宮崎銀行
	137	株式会社山口フィナンシャルグループ
協力機関	138	大分県LSIクラスター形成推進会議
	139	かごしまモノづくり推進協議会
	140	一般財団法人日本気象協会 九州支社
	141	公益財団法人北九州産業学術推進機構
	142	一般財団法人九州オープンイノベーションセンター
	143	公益財団法人九州経済調査協会
	144	一般社団法人九州経済連合会
	145	公益財団法人九州先端科学技術研究所
	146	一般社団法人熊本県工業連合会
	147	公益財団法人佐賀県産業振興機構
	148	国立研究開発法人産業技術総合研究所 九州センター
	149	SEMIジャパン
	150	公益社団法人全国学習塾協会 九州・沖縄支部
	151	独立行政法人中小企業基盤整備機構 九州本部
	152	一般社団法人電子情報技術産業協会
	153	独立行政法人日本貿易振興機構 福岡貿易情報センター
	154	公益財団法人福岡県産業・科学技術振興財団
	155	明倫国際法律事務所

※赤字は2025年4月1日以降に追加された構成機関

※太字は当初メンバー。区分毎に五十音順（行政機関除く）

九州半導体人材育成等コンソーシアムの活動指針

中期行動計画の策定

コンソーシアム活動の指針を確認するとともに、構成機関に活動のマイルストーン（取組内容・時期）を示すことで、コンソーシアム活動への更なる理解促進と求心力向上に繋げるため、**中期行動計画（MVV・KPI・Action）**を策定。

Mission：コンソーシアムの使命

半導体で豊かな未来社会を九州から実現する

Vision：コンソーシアムが目指す姿（なりたい状態、あるべき姿）

- ・多様な半導体人材が集い生き活きと活躍する九州
- ・半導体とともに歩み成長を続ける九州
- ・グローバルな半導体エコシステムの一翼を担う九州

Value：コンソーシアムがもたらす価値 （やるべきこと、共通の価値観、行動指針）

- ・半導体の魅力発信と人材育成を担う産学官金プラットフォーム
- ・産業競争力の強化に資する半導体バリューチェーン
- ・半導体産業の発展に貢献する九州から世界へのクロスポイント

KPI：半導体人材の育成・確保

コンソーシアム構成機関による
「魅力発信」「人材育成・確保」の取組を
多くの学生や社会人に届ける。

＜構成機関が実施する活動に参加した延べ人数＞

【実績】2024年度 累計約13.5万人（74機関）

【目標】2026年度末 累計40万人（180機関※）

2031年度末 累計140万人（200機関※）

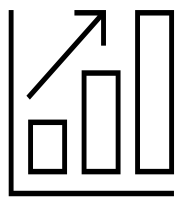
※当該年度のコンソ構成機関数見込

コンソーシアム設立～2025年度の活動（累計・予定含む）

コンソーシアム設立後 人材育成・確保に取り組んだ機関数・人材数
(括弧は前回調査値)

84機関
(74機関)

363,939名
(134,663名)



小中高生向け	116,556名
高専・大学生向け	90,940名
大学院生向け	29,972名
その他	126,471名

※コンソーシアムでの把握分を含む

半導体関連
・講義新設
・学部学科の新設、定員増

23校

半導体関連講義、人材育成拠点の新設

高校・工業高校	3校
高専・大学・大学院	10校

学部学科の新設、定員増

高校・工業高校	4校・60名
高専・大学・大学院	6校・281名

半導体教育における連携協定
※コンソーシアムでの把握分を含む

20件



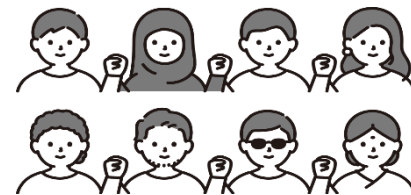
- ・九州大学×陽明交通大学（台湾）
- ・有明高専×東京大学大学院
- ・長崎総合科学大学×イサハヤ電子
- ・熊本大学×立命館

等

2025年度の活動（単年・予定含む）

海外人材活躍に向けた魅力発信、研修
実施機関数・参加人数

5機関 **620**
名以上



若年層向けに行う半導体魅力発信のための
ワークショップやイベント、実験キット開発
実施機関数・参加人数

実施機関 **64**機関
参加者 **51,000**
名以上

工場見学実施社数・参加人数

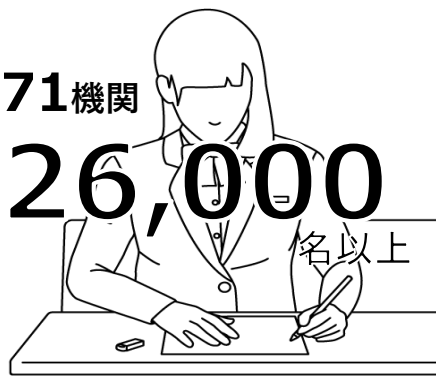
9,700
名以上

- ・実施企業 **16**社
- ・企画した教育機関・行政 **6**機関

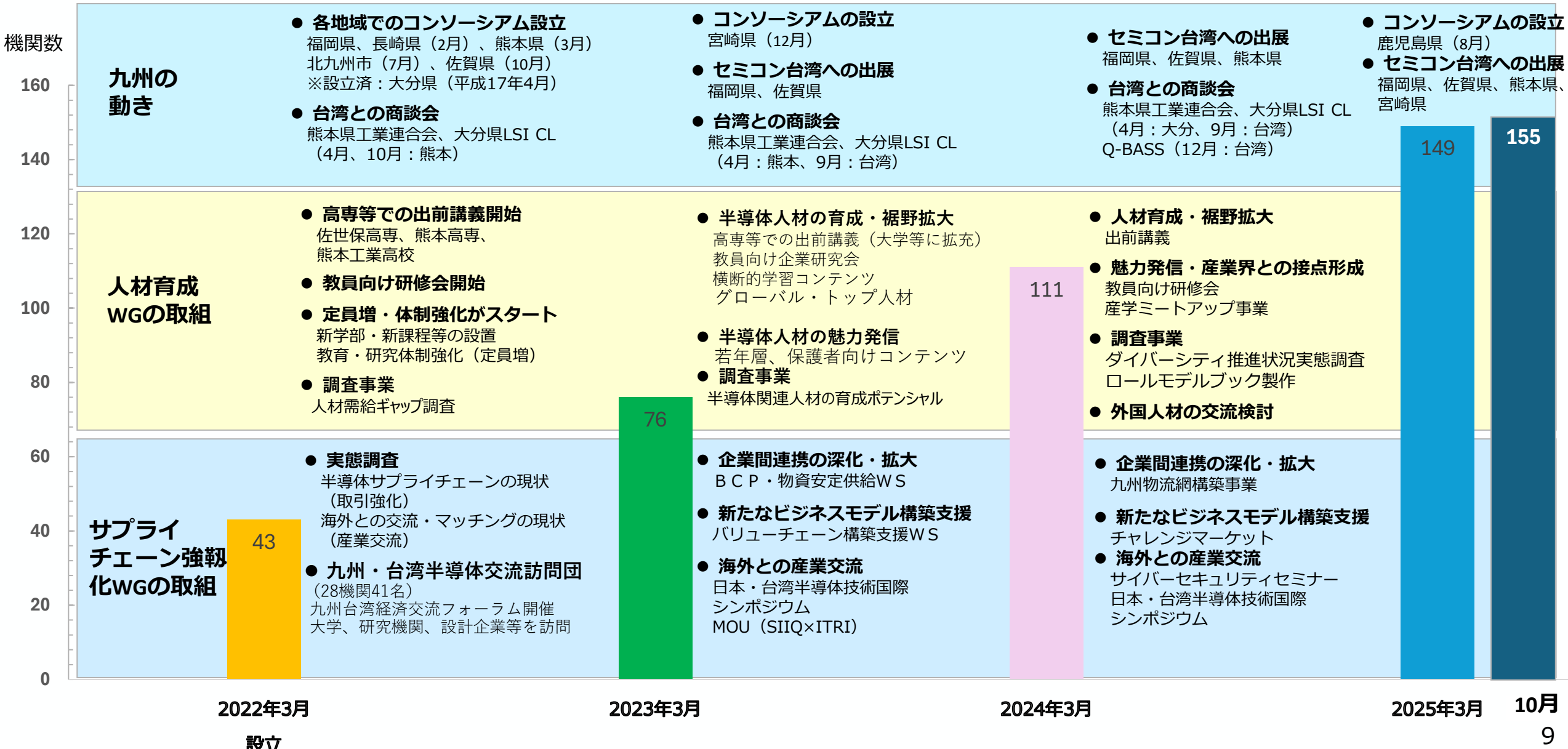


出前授業の実施機関数・参加人数

71機関 **26,000**
名以上



コンソーシアム活動の振り返り

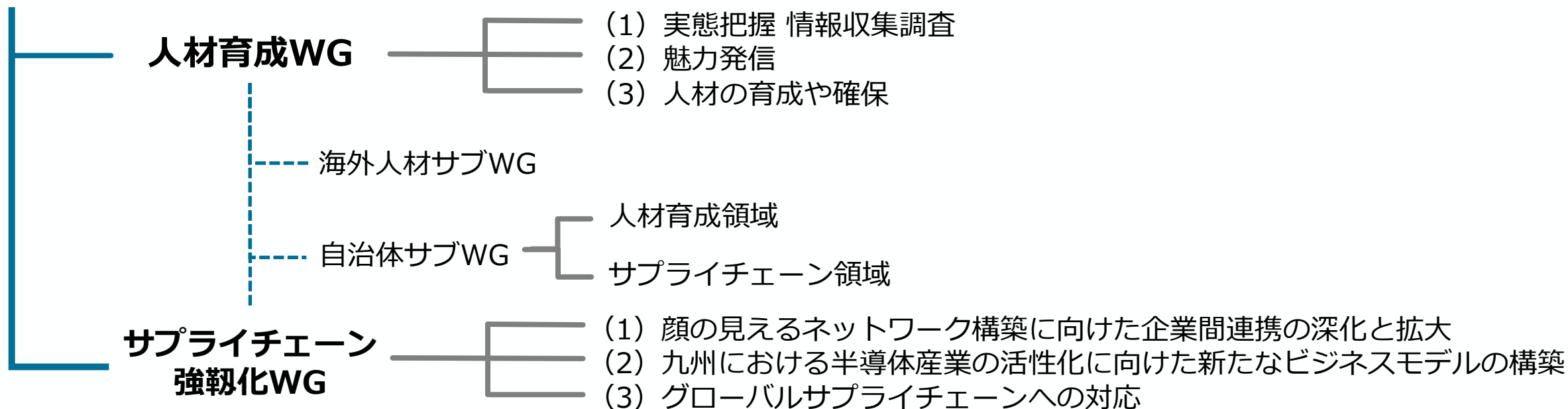


各WGの位置づけ

概要

- 九州半導体人材育成等コンソーシアム（以下、「コンソーシアム」という。）の取組は、**全体会合**において構成機関間で共有と意識の統一を行う。
- 取組の具体化と実行は、**コンソーシアムの下に設置する2つのワーキンググループ**（以下、「WG」）（人材育成、サプライチェーン強靱化）において行う。
- WGには、構成機関や有識者等が参加し、事務局は一般社団法人九州半導体・デジタルイノベーション協議会（以下、「SIIQ」）が担う。
- WGの下に**サブWG**を設置。

九州半導体人材育成等コンソーシアム



人材育成WGスケジュール

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
全体会合								第7回 会合					第8回 会合
人材育成WG					7/23 第1回 WG		9/19 第2回 WG				次年度 方針検討		3/4 第3回 WG
実態把握 情報収集 調査	半導体人材需給ギャップ（フォローアップ）調査 サプライチェーンマップ更新		アンケート票作成			アンケート票発送・回収			集計・分析		結果まとめ		●公表
	構成機関における人材育成・確保の 取組状況調査		アンケート票作成			アンケート票 発送・回収	集計・分析 結果まとめ	●公表					
半導体産業 の魅力発信	教員向け研修会				●7/25 三菱電機	●8/28 日清紡マイクロバ イスAT					●1/15 ラピスセミコンダク タ		
	産学ミートアップ				●8/4 SUMCO	●8/21 大分開催					●1月中下旬 フェニテックセミコンダクター		●2/18 長崎開催
半導体人材の 育成・確保	出前授業・横断的教育	出前授業（大学・高専・高校）											
	産学連携による教育・研究環境の整備 （装置類寄付構築・講義開放）		仕様検討					アンケート票発送・回収		集計			限定公表●
ダイバーシティ推進	【海外人材サブWG】 海外人材活用に向けた検討		組成準備 方針検討			9/2 第1回 サブWG			第2回 サブWG		議論結果 まとめ		第3回 サブWG
横断的な取組	【自治体サブWG（人材育成領域）】 自治体連携に向けた検討		5/21 第1回 サブWG		連携取組 の検討		9/3 第2回 サブWG					第3回 サブWG	

サプライチェーン強靱化WGスケジュール

	4～6月	7～9月	10～12月	1～3月
コンソーシアム 全体会合			●10月17日 第7回	●第8回
SC強靱化WG 全体会合		●7月8日WG① 今年度の取組み	●10月3日 WG② 中間報告	●WG③ 年度最終報告
1. ビジネス創出・拡大に向けた取組	チャレンジマーケット2024 フォローアップ ○企画調整	募集開始 9月24日	●ニーズ説明会 10月21日	●チャレンジマーケット2025 12月19日開催 ○フォローアップ
2. 企業間連携によるネットワークの構築		企業間交流会（2回開催予定） ●1月30日 企業間交流会① @大分港 ●時期未定 企業間交流会②		
		九州物流網構築(骨子メンバーでの協議)	●実証調査	●フォローアップ、事業化検討
3. グローバルサプライチェーンへの対応	●4月16日 建築マネジメントセミナー		●セミナー① 時期未定	●セミナー② 時期未定
	台湾との産業交流	●9月 SEMICON台湾 台湾・日本半導体技術国際シンポジウムなど	●セミナー③ 時期未定	意見交換等、適宜実施
【共有】 サプライチェーンマップ更新		アンケート 内容決定	アンケート実施	集計・分析
			マップ作成 (原版・印刷版)	★印刷完了 (2月予定)
【横断的な取組】 自治体サブWG	●WG① 5月21日	●意見交換 (テーマ：人材育成) 9月3日	●WG② 11月予定	

台湾訪問報告（概要）

- 「九州半導体人材育成等コンソーシアム」は、半導体分野における「人材育成・確保」、「サプライチェーン強靱化」、「海外との産業交流」の3本柱で活動を推進。
- これまで、「海外との産業交流」として台湾へ2023年2月を最初に複数回、訪問団を派遣。
 - ・2023年と2024年、9月のセミコン台湾開催に合わせて双方の産学官による「日台半導体技術国際シンポジウム」を開催
 - ・2023年のシンポジウムでは、「SIIQ（（一社）九州半導体・デジタルイノベーション協議会）×ITRI（工業技術研究院）」、「九州大学×陽明交通大学×ITRI」でMOUを締結
- 今回は、台湾との更なる交流深化を図るため以下の取り組みを実施。
 - ①上記のMOUに基づく「日台半導体3Dパッケージング技術国際シンポジウム」の開催およびビジネスマッチング
 - ②日台のサプライチェーン構築事例の確認と、九州コンソ参画機関への情報還元を目的とした現地企業視察
 - ③「サプライチェーン強靱化」に寄与する九台産業交流の枠組み形成充実を目的とする、台湾の半導体関連産業団体の現況調査と協力関係構築に向けた意見交換、ネットワーク形成

1. 日程 2025年9月7日（日）～ 同 9月12日（金） ※9月7日、9月12日は移動日

2. 参加者 6 機関16名 ※現地合流を含む

九州経済産業局 星野局長（九州半導体人材育成等コンソーシアム 代表幹事）・情報政策課 樋上課長・小柳係長、
SIIQ 山口会長（ソニーセミコンダクタマニファクチャリング(株)代表取締役社長）・古賀事務局長・神田技術部長、
九州大学、パナソニックホールディングス(株)、パナソニックコネクト(株)、マクセル(株)

3. 訪問先

- ①台北市：日台科技サミットフォーラム（台日科技高峰论坛）、台日半導体科技促進会 発足レセプション、
商談会（大分県LSIクラスター形成推進会議、（一社）熊本県工業連合会、台湾電子製造設備工業同業公会※TEEIA）、
台湾区電機電子工業同業公会※TEEMA、セミコン台湾、日台半導体3Dパッケージング技術国際シンポジウム
- ②桃園市：永泉晶圓
- ③新竹市：工業技術研究院※ITRI

①2025日台半導体3Dパッケージング技術国際シンポジウム @台北南港展覽館1館

◇シンポジウム概要

主 催：九州半導体人材育成等コンソーシアム、SIIQ、ITRI
共 催：台日半導体科技促進会
協 力：陽明交通大学、九州大学
テーマ：3Dパッケージング※

※半導体は前工程による微細化により技術進展を牽引してきたが、技術的な限界に直面。他方、生成AI、高性能コンピューティング、通信、クラウドアプリケーションの膨大な需要は引き続き拡大が見込まれており、世界の主要半導体メーカーは3Dパッケージングを半導体発展を推進する重要な技術分野と位置付け。

◇プログラム

13:00-13:15	ご挨拶	主催者ご挨拶 1.工業技術研究院 副院長 / 胡竹生 2.九州半導体人材育成等コンソーシアム 代表幹事 / 星野 光明 3.九州半導体・デジタルイノベーション協議会(SIIQ) 会長 / 山口 宜洋 4.台日半導体科技促進会秘書長 / 鄭宗宜				
13:15-13:20	記念写真					
		演講テーマ			単位/演講者	
13:20～13:40 (20mins)	特別講演	Advanced Package with Industrial Supply Chain Cooperation			矽品精密 研發中心副總 / 王愉博	
13:40～14:40 (60mins)	技術講演 (20 mins /人)	新材料を用いた三次元集積化技術			九州大学 准教授/ 木野久志	
		陽明交通大学における3Dパッケージング技術の革新的研究と将来展望			陽明交通大学国際半導体学院 院長 / 陳冠能	
		アドバンスパッケージ分野におけるパナソニックの装置ソリューション			パナソニックホールディングス株式会社 部長 / 岩瀬鉄平	
14:40-15:00	休憩Coffee break					
15:00～16:00 (60mins)	技術講演 (20 mins /人)	3Dパッケージングにおける異種統合の応用と課題			工研院電子光電研究所異質統合スマートシステム 組長 /王欽宏	
		マクセルパッケージファウンドリの特徴			Maxell 株式会社 事業本部長付 / 岩田真典	
		3Dパッケージング支柱（TSV/TGV）の先進計測技術			OmniMeasure Technology 策略長 / 王仁杰	
16:00～16:45 (45mins)	Panel discussion Q&A	(詳細内容は別途添付) テーマ：次世代半導体への道を共に切り拓く：日台における3D実装技術協力の深化とその戦略的展望				
		司会者	ITRI 副院長 / 胡竹生 SIIQ 会長 / 山口 宜洋	台湾側 登壇者	1.陽明交通大学 副学長 / 孫元成 2.健鼎科技 處長 / 張培俊 3.台日半導体科技促進会秘書長 /鄭宗宜	日方側 登壇者
16:45～16:50	集合写真	①Panel discussion全員 ② Panel discussion全員+ ご講演の方々				



ITRI 胡副院長



九州半導体コンソ
星野代表幹事



SIIQ 山口会長



台日半導体科技促進会
鄭 秘書長

①2025日台半導体3Dパッケージング技術国際シンポジウム @台北南港展覽館1館

日本・台湾産学官代表者による講演の様子



矽品精密 研发中心
王愉博 副總



九州大学
木野久志 准教授



陽明交通大学
國際半導體學院
陳冠能 院長



パナソニック
ホールディングス(株)
岩瀬鉄平部長



ITRI 電子光電研究所
異質統合スマートシステム
王欽宏 組長



Maxell(株)
岩田真典 事業本部長付

パネルディスカッション



左から
Maxell(株)岩田部長付、パナソニックホールディングス(株)岩瀬部長、九州大学 白谷教授、
SIIQ山口会長、ITRI胡副院長、健鼎科技 張處長、ITRI王組長、陽明交通大 陳冠能 院長

集合写真



①③ITRI施設視察、技術交流(マッチング)イベント @ITRI新竹 中興キャンパス

- ▶ 日本企業2社と、台日半導体科技促進会会員企業2社のビジネスマッチングを開催
- ▶ ITRI 史料文物館等の視察によりITRIの研究開発から社会実装事例を認識して理解を深めるとともに、**ITRI・台日半導体科技促進会※と九州半導体コンソの間で意見交換**を実施 ※2025年5月発足、ITRIがサポート
- ▶ **SIIQ・九州経済産業局・ITRI事務局（産業科学技術国際戦略所※ISTI）**にて3年間の交流振り返りと**今後の連携に係る意見交換**を実施。

<意見交換概要>

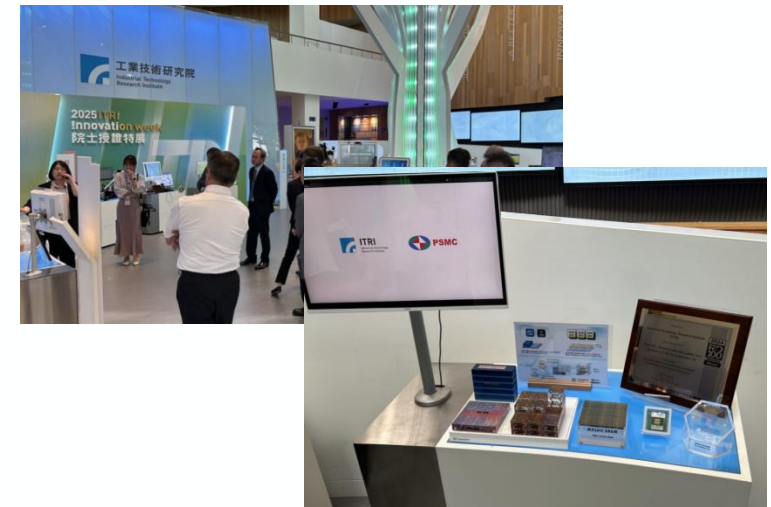
- ・**SIIQ会員**は中小企業が多く、ビジネスマッチングのニーズ大
- ・**ISTI** は、国際交流を糸口に技術開発の促進を図る役割を担っており、九州に対してはR&D能力、資金、リソースが不足している**中堅中小企業にリーチ**するというのも一案（ベストケースは24年の平田機工）
- ・マッチングには、ビジネス交流だけでなく基礎研究から応用研究まで**様々なフェーズ**があり、マッチングを期待する企業は、顧客開拓に加えて既存事業の改善や先を見据えた技術開発など**多様なニーズ**を抱えていることから**ニーズに応じてTEEIA等の他団体と分担**できればよりよい
- ・本イベントは、台湾経済部から**日台国際連携のプラットフォームとして期待**されており、**来年度も工夫を加えて開催**することで**合意**



ITRI 中興キャンパス外観



史料文物館視察



Showroom視察

課題

構成機関から、多くの連携要望をいただいている一方、**担当者の属人的なつながりによる紹介・マッチングにとどまっている**状況。

対策

有益な情報、経験、事例、ノウハウ等の**付加価値のある知識や情報の収集・整理・可視化**等を行い、**コンソーシアム構成機関間の連携促進を強化**していく。

計画

第8回会合（2026年3月予定）において、ナレッジシェアの基本仕様・設計・運用手順などを提示し、**2026年度にシステム構築及び運用開始**を目指す。

スキーム（仕組み）イメージ



▼共有イメージ（企業・研究機関／シーズの場合）

【企業・研究機関：シーズ】												
	コンテンツの種別	コンテンツ概要	対象						コンタクト要否	共有可否	担当者情報	
機関名			小中学生	高校生	大学生	大学院生	社会人	その他			部署名・役職	氏名
〇〇マニュファクチャリング株式会社	教材提供	・半導体オンライン教材 産業界と連携して構築した学習リソースを無償提供し、学生のキャリア発展をサポートします。	○						不要 (HP公表済み)	すべて共有可		
株式会社〇〇	教材提供	・半導体業界探求教材 中高校生の段階から業界や地域の企業について学習できる探求教材です。	○	○					不要	コンテンツ情報のみ共有可		
〇〇デザイン株式会社	講座提供・講師派遣（出前講義）								要	すべて共有可		
〇〇工業株式会社	インターン受入	理系学生（大学生・既卒後3年以内の方）向けインターンシップの受入			○		○		要	すべて共有可		
株式会社〇〇	工場見学受入								要	すべて共有可		
〇〇株式会社	中古設備の寄附	・マルチフィールドデスタ（メーカー：〇〇(株)） 10年利用の中古装置、問題無く稼働 輸送費の負担可 このほか詳細は個別相談							要	すべて共有可		